

Pâte thermique GD-3, 3 g, 7,5 W/m²K

Codes produits :

Référence AM6848

EAN13 : -

CUP : 38249996

caractéristiques du produit :

Couleur: Gris

Max. température de fonctionnement:
120 °C

Conductivité thermique: 7,5 W/mK



Attributs du produit :

Description du produit :

La pâte thermoconductrice GD-3 est conçue pour améliorer le transfert de chaleur entre les composants électroniques et les dissipateurs thermiques. Elle est utilisée lors de l'assemblage ou de la maintenance des processeurs, des LED et autres composants soumis à de fortes contraintes thermiques, où elle contribue à combler les irrégularités microscopiques entre les surfaces de contact.

Spécifications techniques

- Désignation : GD-3
- Type de produit : pâte thermique
- Conditionnement : seringue
- Couleur : gris
- Poids de la recharge : 3 g
- Conductivité thermique : 7,5 W/m K
- Densité : 2,5 g/cm³
- Température de fonctionnement : -35 à +120 °C
- Utilisation prévue : pour les processeurs, les LED et autres composants nécessitant une dissipation thermique.

Fonctions et caractéristiques

- Elle sert d'interface thermoconductrice entre le composant et le dissipateur thermique.
- La conception de la seringue permet un dosage plus précis lors de l'application.
- La pâte grise est destinée à être appliquée sur les surfaces de contact des éléments refroidis.
- Convient pour une utilisation en électronique et lors du montage de dissipateurs thermiques sur des éléments semi-conducteurs.

Idéal pour

- Installation et maintenance des processeurs.
- Applications avec modules LED et refroidisseurs LED.
- Composants électroniques nécessitant un transfert de chaleur vers un dissipateur thermique.
- Services d'entretien et d'installation dans le domaine du refroidissement électronique.

Contenu de l'emballage

- 1 tube de pâte thermique GD-3 en seringue, 3 g

Pourquoi choisir ce produit ?

- Un produit clairement conçu pour la connexion thermique entre le composant et le dissipateur thermique.
- Valeur de conductivité thermique connue, fournie dans les documents d'entrée.
- Le conditionnement de la seringue facilite une application contrôlée.
- Convient pour l'entretien, la maintenance et l'installation de nouveaux appareils électroniques.

Instructions d'installation et d'utilisation

- Nettoyer et dégraisser les deux surfaces de contact avant application.
- Appliquez la pâte en une couche fine et continue uniquement sur la zone de contact désignée.
- Des quantités excessives peuvent détériorer la qualité de la liaison thermique et contaminer les pièces environnantes.
- Après application, assurez-vous d'exercer une pression adéquate du dissipateur thermique sur le composant.

Avis de sécurité

- Utilisez ce produit uniquement pour transférer de la chaleur entre des surfaces de contact appropriées.
 - Évitez tout contact de la pâte avec les connecteurs, les contacts et
-

autres pièces non destinées à cette application.

- Ne pas appliquer sur un équipement sous tension.
- Tenir hors de portée des enfants.

Galerie de produits :